PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-305915

(43)Date of publication of application: 28.10.1992

(51)Int.CI.

H01L 21/027

G03F 7/20

(21)Application number: 03-094867

(71)Applicant: NIKON CORP

(22)Date of filing:

02.04.1991

(72)Inventor:

OZEKI HISAO

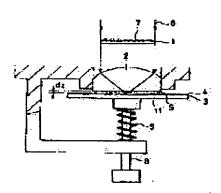
MATSUBARA TAKASHI

(54) ADHESION TYPE EXPOSURE DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To make thin the film thickness of an immersion liquid interposed between a photo-mask or an optical projection system and a wafer and reduce the quantity of light absorbed, and to minimize and prevent exposure unevenness in an adhesion type exposure device.

CONSTITUTION: A wafer 3 coated with a photoresist 4 is fast stuck on an exposure lens 2 through an immersion liquid 5. A surface-active agent 11 is mixed into the immersion liquid 5 within a range that the photoresist 4 is not affected, and the surface-active agent 11 reduces the surface tension of the immersion liquid 5, and improves wettability. Accordingly, the film thickness d2 of the immersion liquid is made thinner than the case where surface-active agent is not mixed.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平4-305915

(43)公開日 平成4年(1992)10月28日

(51) Int.Cl. ⁵		識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
H01L	21/027				
G 0 3 F	7/20	5 2 1	7818-2H		
			7352-4M	H01L 21/30	3 1 1 A

審査請求 未請求 請求項の数1(全 3 頁)

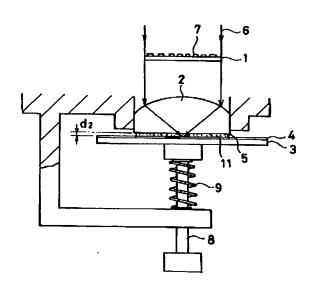
(21)出願番号	特顧平3-94867	(71)出顧人	000004112
			株式会社ニコン
(22)出顧日	平成3年(1991)4月2日		東京都千代田区丸の内3丁目2番3号
		(72)発明者	大関 尚夫
			東京都品川区西大井一丁目6番3号 株式
			会社ニコン大井製作所内
		(72)発明者	松原隆
			東京都品川区西大井一丁目6番3号 株式
			会社ニコン大井製作所内
		(74)代理人	弁理士 山川 政樹

(54) 【発明の名称】 密着型露光装置

(57)【要約】

【目的】 密着型露光装置において、フォトマスクまた は投影光学系とウエハとの間に介在される浸液の膜厚を 薄くして光の吸収量を少なくし、露光ムラを軽減防止す ることを目的とする。

【構成】 フォトレジスト4を塾布されたウエハ3を露光レンズ2に浸液5を介して密着させる。浸液5にはフォトレジスト4に影響を与えない範囲で界面活性剤11 が混入されており、界面活性剤11は、浸液5の表面張力を減らし、濡れ性を高める。したがって、浸液の膜厚d1 は界面活性剤を混入しない場合より薄くなる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 フォトレジストを強布されたウエハを投 影光学系もしくはフォトマスクに浸液を介して密着さ せ、照射光の照射によりフォトマスクのパターンを前記 フォトレジストに転写するようにした密着型露光装置に おいて、前配浸液は前記フォトレジストに影響を与えな い範囲で界面活性剤が混入されていることを特徴とする 密着型露光装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、LSIの製造工程において、フォトマスク上のパターンをウエハ上に投影の形する露光装置、特に密着型露光装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】レーザー光等を照射しフォトマスク上の パターンを投影光学系によってシリコンウエハ等の半導体基板上に投影露光するこの種の露光装置における露光 方式としては、①密着(コンタクト)露光方式、②プロ キシミティ露光方式、③反射型投影露光方式、④縮小レ 20 ンズ投影露光方式の4方式が知られている。

【0003】このうち密着露光方式は、フォトマスク (または投影光学系)とウエハとを密着させて露光するもので、これらが完全に密着している場合には、フォトレジスト中の波長が屈折率分の1に短くなるため、回折の影響が少なく、高解像度の転写が得られるという特色を有している。この密着は真空吸着、静電チャック等によって行っている。しかし、完全な密着を実現することは極めて難しく、またフォトマスクとウエハとを機械的に接触させているためにウエハ表面の突起等によりフォトマスクに欠陥が生じ、その寿命を低下させると同時にデバイスの歩留りに影響を及ぼすといった問題があった。

【0004】そこで、密着露光方式によるこのような問 題を解決する方法としてフォトマスクとウエハ間に液体 (浸液)を充填している。図2はウエハを浸液を介して 投影光学系に密着させた場合を示すもので、1はフォト マスク、2は投影光学系の一部を構成する露光レンズ、 3はフォトレジスト4が塗布されたウエハ、5は露光レ ンズ2とウエハ3間に充填された浸液、6はフォトマス 40 ク1のパターン7を照射しフォトレジスト4を露光する 照射光、8はウエハ3を保持する保持体、9は保持体8 を上方に付勢しウエハ3を露光レンズ2に所定圧にて押 し付ける圧縮コイルばねである。照射光6の波長は短い ほど回折の影響が少なく、そのため光源としてエキシマ レーザー等のレーザー装置が用いられる。 浸液 5 として は、屈折率がフォトレジスト4と同程度で光の吸収が少 なく、しかもフォトレジスト4を溶かさないものが望ま しく、通常純水が使用される。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述したような浸液5を使用した密着型露光装置においては、 浸液5自身の膜厚ムラがあると、浸液5による服射光6 の吸収量にムラが生じるため、コンタクト露光されたフォトレジスト4のパターンが的確に露光されている部分

2

オトレジスト4のパターンが的確に露光されている部分とそうでない部分とが生じてしまうという問題があった。したがって、このような露光ムラの発生を防止するため、浸液5の濡れ性を高めて表面張力を下げ、膜厚d を極力薄くすることが望まれている。

10 【0006】本発明は上述したような従来の問題点および要望に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、浸液の膜厚を薄くし、浸液による露光ムラを軽減防止し得るようにした密着型露光装置を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は上記目的を達成するため、フォトレジストを塗布されたウエハを投影光学系もしくはフォトマスクに浸液を介して密着させ、照射光の照射によりフォトマスクのパターンを前記フォトレジストに転写するようにした密着型露光装置において、前記浸液は前記フォトレジストに影響を与えない範囲で界面活性剤が混入されているものである。

[0008]

【作用】本発明において界面活性剤は浸液の濡れ性を高め、表面張力を下げる。したがって浸液の膜厚を薄くする。

[0009]

【実施例】以下、本発明を図面に示す実施例に基づいて 詳細に説明する。図1は本発明に係る密着型離光装置の 一実施例を示す要部の断面図である。なお、図中図2と 同一構成部品のものに対しては同一符号を以て示し、そ の説明を省略する。

【0010】本実施例は投影光学系にウエハを密着させた場合を示すもので、フォトマスク投影光学系の一部を構成する露光レンズ2とウエハ3との間に介在される純水等の浸液5に界面活性剤11を混入したものである。

【0011】界面活性剤11としては、陽イオン性、陰イオン性、非イオン性等種々のものが使用可能であるが、屈折率が浸液5と同程度で光の吸収が少なく、またフォトレジスト4を溶かしたりすることのない範囲で混入されることが望ましい。特に、陽イオン性のうち四般アンモニウム塩系は、濡れ性も高く、レジストへの影響も少なく、光の吸収も少ないため好ましい。

【0012】かくしてこのような構成においては界面活性剤11が浸液5の表面張力を減らして濡れ性を高めるため、ウエハ3を所定圧力にて露光レンズ2に圧接した際、浸液5の膜厚d:を図2に示した従来装置と比較して薄くする(d:くd:)ことができ、また膜厚が薄くなれば光の吸収量も少なくなるので、これに比例して光50の吸収ムラが減少し、露光ムラを軽減防止することがで

3

きるものである.

[0013]

【発明の効果】以上説明したように本発明に係る密着型 講光装置によれば、浸液に界面活性剤を混入することに より、浸液自身の表面張力を減らして濡れ性を向上させ るようにしたので、浸液の膜厚を薄くすることができ る。したがって、浸液の膜厚ムラが小さく、光の吸収を 少なくすることができ、浸液による露光ムラを軽減防止 することができる。

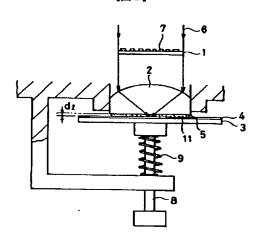
【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る密着型露光装置の一実施例を示す 要部の断面図である。 【図2】密着型電光装置の従来例を示す要部の断面図である。

【符号の説明】

- 1 フォトマスク
- 2 電光レンズ
- 3 ウエハ
- 4 フォトレジスト
- 5 浸液
- 6 照射光
- 10 7 マスク
 - 11 界面活性剤





[図2]

